

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司获得政府补助的基本情况

近日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家科技重大专项—02 专项国拨经费人民币 21,446,100.00 元，该项资金为公司独立承担的“国产中道工艺高端封测装备与材料量产应用工程”项目（课题编号：2017ZX02518）的验收后补助资金。该项目实施期间为 2017 年至 2019 年，项目目标以汽车电子及智能制造需求为牵引，针对智能传感器高性能、高可靠性、高集成度等需求，突破现有晶圆级封装及传统封装的局限性，开发新一代智能传感器先进封装工艺，以实现其在汽车电子及智能制造等高端领域的大规模产业化应用。

项目经过三年实施顺利完成了各项任务目标，成功开发了针对新一代智能传感器高可靠性的中道先进封装和后道集成封装工艺，包括晶圆级 TSV，芯片级扇外型封装和系统级 SiP 封装等核心工艺，涵盖了从低像素到高像素，小尺寸到大尺寸，单芯片到多芯片，消费类到车规级等更丰富完整的封装能力。项目的成功实施使公司具备了为客户提供客制化、一站式封装技术的开发与量产服务能力，不仅提高了公司在消费类、安防数码等应用领域的封装能力与市场应用，更为公司向汽车电子、智能制造等新兴应用领域的拓展奠定了坚实的技术、产业、客户与人才基础。

二、补助类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述补助，其

中与收益相关的政府补助 15,035,705.26 元,将计入 2021 年当期损益(其他收益);与资产相关的政府补助 6,410,394.74 元,将计入递延收益,并按相关规定进行逐年摊销。

公司对上述政府补助的会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2021 年 2 月 27 日